



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222443286 U

(45) 授权公告日 2025. 02. 11

(21) 申请号 202420907902.2

A43B 13/12 (2006.01)

(22) 申请日 2024.04.28

A43B 13/04 (2006.01)

A43B 5/00 (2022.01)

(73) 专利权人 三六一度(中国)有限公司

地址 362200 福建省泉州市晋江市经济开发
区(五里园)灵源灵翔路5号

专利权人 三六一度(福建)体育用品有限公司

(72) 发明人 林金攀 陈振波 郑建山 彭达武

(74) 专利代理机构 厦门纳益维知专利代理事务
所(普通合伙) 35273

专利代理师 黄华

(51) Int. Cl.

A43B 13/14 (2006.01)

A43B 13/22 (2006.01)

A43B 13/18 (2006.01)

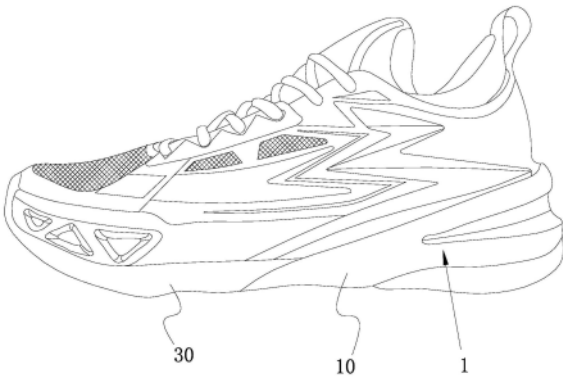
权利要求书1页 说明书5页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种耐磨鞋底及鞋子

(57) 摘要

本实用新型涉及鞋子领域,提供了一种耐磨鞋底及鞋子,耐磨鞋底包括第一中底和第二中底,第一中底底面设有耐磨花纹,顶面设置有轮廓槽,轮廓槽的侧壁形成耐磨鞋底的包边结构;第二中底填设于轮廓槽内;第一中底和第二中底均为发泡中底,第一中底的硬度大于或等于55C,第二中底的硬度小于第一中底的硬度。第一中底具有良好的耐磨性,配合大底粘合,整个鞋底的耐磨性能较好,且耐磨区可以采用贴合的方式设计,能够形成良好的耐磨性,使得易磨损区域,具有良好的耐磨性。第二中底采用EVA发泡材料制作,使得耐磨鞋底与人体接触的部位较为柔软,因此在踩踏时,可以提供良好的舒适性。



1. 一种耐磨鞋底,其特征在于,包括:

第一中底(10),其底面设有耐磨花纹,顶面设置有轮廓槽(103),所述轮廓槽(103)的侧壁形成耐磨鞋底的包边结构(104);及

第二中底(20),其填设于所述轮廓槽(103)内;

所述第一中底(10)和第二中底(20)均为发泡中底,所述第一中底(10)的硬度大于或等于55C,所述第二中底(20)的硬度小于第一中底(10)的硬度;

所述第一中底(10)为包含足弓区和后脚掌区的半掌结构,所述轮廓槽(103)于前脚掌区外侧设置有缺口(1031),所述第二中底(20)的前脚掌区设置有与所述缺口(1031)卡合的包边凸起(201)。

2. 根据权利要求1所述的耐磨鞋底,其特征在于:所述第一中底(10)为EVA发泡中底,所述第二中底(20)为ETPU发泡中底。

3. 根据权利要求1或2所述的耐磨鞋底,其特征在于:所述第一中底(10)底面的后脚掌区边缘区域上设置有耐磨区(101),所述耐磨区(101)与所述第一中底(10)一体成型设置或拼合设置,所述第一中底(10)的底面前脚掌区设置有耐磨槽(102);

所述第二中底(20)与所述第一中底(10)之间设置有碳板,所述耐磨槽(102)上设置有大底(30)。

4. 根据权利要求3所述的耐磨鞋底,其特征在于:还包括设置在所述包边凸起(201)外侧上的包边片(50),所述包边片(50)的底部设置在所述大底(30)与所述第一中底(10)之间,所述包边凸起(201)的外侧面上设置有若干个固定凸起(202),所述包边片(50)上设置有与所述固定凸起(202)卡合的通孔(501)。

5. 根据权利要求4所述的耐磨鞋底,其特征在于:所述第二中底(20)的前脚掌区且靠近耐磨鞋底内侧面设置有闭环凹槽(203),所述闭环凹槽(203)上设置有嵌合的第一加强片(2031),所述第一加强片(2031)与所述包边片(50)一体成型设置。

6. 根据权利要求5所述的耐磨鞋底,其特征在于:所述第一中底(10)于耐磨鞋底内侧设置有延伸部(109),所述延伸部(109)上设置有第一拼接槽(1011),所述第一中底(10)的足弓区内侧区设置有与所述第一拼接槽(1011)连通的第二拼接槽(1012),所述第一中底(10)的足弓区外侧区设置有与所述闭环凹槽(203)连通的第三拼接槽(1013);所述第一拼接槽(1011)、所述第二拼接槽(1012)和所述第三拼接槽(1013)形成所述耐磨槽(102)。

7. 根据权利要求6所述的耐磨鞋底,其特征在于:所述第一中底(10)与所述大底(30)于拼接线位置处设置有观测所述第一加强片(2031)的第一窗口(100)。

8. 根据权利要求5所述的耐磨鞋底,其特征在于:所述第一中底(10)的后脚掌侧面上设置有马蹄形的第二加强片(105),所述第一中底(10)的外侧面上设置有第三加强片(106),所述第三加强片(106)设置在前脚掌区与后脚跟之间。

9. 根据权利要求3所述的耐磨鞋底,其特征在于:所述第一中底(10)的足弓区上设置有至少一个连通至所述碳板的第二窗口(107);所述第一中底(10)的后脚掌区上设置有连通至所述第二中底(20)的第三窗口(108)。

10. 一种鞋子,其特征在于,包括如权利要求1~9任一项所述的耐磨鞋底(1)。

一种耐磨鞋底及鞋子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋子领域,具体涉及一种耐磨鞋底及鞋子。

背景技术

[0002] 鞋子是用来保护足部,便于行走的穿着物。由皮革、布帛、胶皮等材料制成。如今市场上鞋的款式可谓琳琅满目,千变万化。但不少鞋子较为重视样式而忽略了舒适性和实用性,因此不少人穿上时髦的鞋子后痛若不堪的现象时有发生。

[0003] 穿鞋是物质享受,也是身心享受,买鞋子最重要的是感到舒适,其次才是美观。穿着不合适的鞋子,也会有损健康,甚至会引发多种疾病。当穿上过小或过紧不合脚的鞋走路,脚会起泡,脚会很快疲劳。

[0004] 特别是具有运动的项目,对于鞋子的性能和舒适性要求更高。例如篮球运动,不仅需要具有良好的弹性性能,同时还需要具有良好的耐磨性,以此保证鞋子穿着的舒适性和使用寿命。但是,现今鞋子的在整体的重量上会较重,导致运动时间长久后,对于脚部的负担更大,即更容易导致疲劳;以及,鞋底过硬,导致舒适性降低;或者鞋底较软,使得耐磨性较低,易损坏等问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种耐磨鞋底及鞋子,旨在改善现有篮球鞋的穿着的舒适性较低的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种耐磨鞋底,包括:

[0007] 第一中底,其底面设有耐磨花纹,顶面设置有轮廓槽,所述轮廓槽的侧壁形成耐磨鞋底的包边结构;

[0008] 第二中底,其填设于所述轮廓槽内;

[0009] 所述第一中底和第二中底均为发泡中底,所述第一中底的硬度大于或等于55C,所述第二中底的硬度小于第一中底的硬度。

[0010] 优选的,所述第一中底为EVA发泡中底,所述第二中底为ETPU发泡中底。

[0011] 优选的,所述第一中底底面的后脚掌区边缘区域上设置有耐磨区,所述耐磨区与所述第一中底一体成型设置或拼合设置,所述第一中底的底面前脚掌区设置有耐磨槽;

[0012] 所述第二中底与所述第一中底之间设置有碳板,所述耐磨槽上设置有大底。

[0013] 优选的,所述轮廓槽于前脚掌区外侧设置有缺口,所述第二中底的前脚掌区设置有与所述缺口卡合的包边凸起;还包括设置在所述包边凸起外侧上的包边片,所述包边片的底部设置在所述大底与所述第一中底之间,所述包边凸起的外侧面上设置有若干个固定凸起,所述包边片上设置有与所述固定凸起卡合的通孔。

[0014] 优选的,所述第二中底的前脚掌区且靠近耐磨鞋底内侧面设置有闭环凹槽,所述闭环凹槽上设置有嵌合的第一加强片,所述第一加强片与所述包边片一体成型设置。

[0015] 优选的,所述第一中底为包含足弓区和后脚掌区的半掌结构,所述第一中底于耐

磨鞋底内侧设置有延伸部,所述延伸部上设置有第一拼接槽,所述第一中底的足弓区内侧区设置有与所述第一拼接槽连通的第二拼接槽,所述第一中底的足弓区外侧区设置有与所述闭环凹槽连通的第三拼接槽;所述第一拼接槽、所述第二拼接槽和所述第三拼接槽形成所述耐磨槽。

[0016] 优选的,所述第一中底与所述大底于拼接线位置处设置有观测所述第一加强片的第一窗口。

[0017] 优选的,所述第一中底的后脚掌侧面上设置有马蹄形的第二加强片,所述第一中底的外侧面上设置有第三加强片,所述第三加强片设置在前脚掌区与后脚跟之间。

[0018] 优选的,所述第一中底的足弓区上设置有至少一个连通至所述碳板的第二窗口;所述第一中底的后脚掌区上设置有连通至所述第二中底的第三窗口。

[0019] 还提供一种鞋子,包括如上述的耐磨鞋底。

[0020] 采用上述技术方案后,本实用新型与背景技术相比,具有如下优点:

[0021] 1、第一中底的硬度设计大等于55C,具有良好的耐磨性,配合大底粘合,整个鞋底的耐磨性能较好,且耐磨区可以采用贴合的方式设计,能够形成良好的耐磨性,使得易磨损区域,具有良好的耐磨性。

[0022] 2、第二中底采用相对柔软的材料制作,使得耐磨鞋底与人体接触的部位较为柔软,因此在踩踏时,可以提供良好的舒适性。

[0023] 3、耐磨鞋底内放入碳板,可以保证鞋底的弹性性能,因此可以极大的降低鞋底的重量,使得鞋底较为轻盈,降低对人体的负重,提高使用的舒适性。

附图说明

[0024] 图1为本实用新型所述的耐磨鞋底的侧面的结构示意图;

[0025] 图2为本实用新型所述的耐磨鞋底的底面的结构示意图;

[0026] 图3为本实用新型所述的耐磨鞋底的底面的爆炸示意图;

[0027] 图4为本实用新型所述的耐磨鞋底的底面的局部示意图;

[0028] 图5为本实用新型所述的鞋子的结构示意图;

[0029] 附图标记说明:

[0030] 1、耐磨鞋底;

[0031] 10、第一中底;100、第一窗口;101、耐磨区;102、耐磨槽;103、轮廓槽;104、包边结构;105、第二加强片;106、第三加强片;107、第二窗口;108、第三窗口;109、延伸部;110、耐磨花纹;

[0032] 1011、第一拼接槽;1012、第二拼接槽;1013、第三拼接槽;

[0033] 1031、缺口;

[0034] 20、第二中底;201、包边凸起;202、固定凸起;203、闭环凹槽;

[0035] 2031、第一加强片;

[0036] 30、大底;301、纹理区;50、包边片;501、通孔。

具体实施方式

[0037] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施

例对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0038] 另外,需要说明的是:术语“上”“下”“左”“右”“竖直”“水平”“内”“外”等均为基于附图所示的方位或者位置关系,仅仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或者暗示本实用新型的装置或者元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0039] 当元件被称为“固定于”或者“设置于”或者“设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者间接连接至该另一个元件上。

[0040] 除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或者一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或者两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在实用新型中的具体含义。

[0041] 实施例一

[0042] 请参照图1、图2、图3和图4所示,本实施提供了一种耐磨鞋底,包括第一中底10和第二中底20,第一中底10底面设有耐磨花纹110,第一中底10顶面设置有轮廓槽103,轮廓槽103的侧壁形成耐磨鞋底的包边结构104;第二中底20填设于轮廓槽103内;第一中底10和第二中底20均为发泡中底,第一中底10的硬度大于或等于55C,第二中底20的硬度小于第一中底10的硬度。

[0043] 本实施例中第二中底20和第一中底10可以为不同硬度的EVA发泡材质(乙烯-醋酸乙烯共聚物(也称乙烯-乙酸乙烯共聚物)是由乙烯(E)和乙酸乙烯(VA)共聚而制得,英文名称为:Ethylene Vinyl Acetate,简称EVA)进行制作。优选的,第一中底10为EVA发泡中底,第二中底20为ETPU发泡中底。因为第一中底10的底面需要直接于地面接触,因此第一中底10的硬度需要大等于55C(邵氏硬度C),优选的可以为60C,以保证耐磨鞋底的耐磨性。并且,在第一中底10的底面上设置有耐磨花纹110,通过耐磨花纹110不仅提高防滑性能,还可以提高耐磨性,具有良好的实用性。而第二中底20的硬度则可以相对较低,较为柔软,能够提供良好的弹性,以及穿着的舒适性。

[0044] 进一步地,在第一中底10的轮廓边缘上具有包边结构104,即边缘的凸起部,通过凸起部与鞋帮面进行粘合,达到包覆固定的效果,具有良好的贴合性,提高鞋子结构的稳固性。

[0045] 本实施例中第一中底10底面的后脚掌区边缘区域上设置有耐磨区101,耐磨区101与第一中底10一体成型设置或拼合设置,第一中底10的底面前脚掌区设置有耐磨槽102;第二中底20与第一中底10之间设置有碳板,碳板由鞋跟至鞋足弓部之间设置,耐磨槽102上设置有大底30。

[0046] 对于大底30可以采用橡胶材质进行制作,也可以采用EVA发泡材质或TPU(热塑性聚氨酯)材料制作,并且大底30的硬度大于或等于55C,使得大底30具有优越的耐磨性能和环保性,制作出的耐磨鞋底可以达到耐磨性为 $9.8\text{g}/\text{cm}^2$,回弹性能大等于55Mpa,兼顾舒适和耐磨的性能,即耐磨鞋底具有良好的缓震性、耐磨性和舒适性等优点。

[0047] 具体的,在第一中底10的前脚掌底面粘合上大底30,而在顶面粘合上第二中底20,第一中底10自身具有良好的硬度,配合碳板的结构强度,可以提供良好的弯曲弹性,形成良好的耐磨性,而第二中底20则可提供良好的减震性,也为柔软性。

[0048] 如图3所示,本实施例中轮廓槽103于前脚掌区外侧设置有缺口1031,第二中底20的前脚掌区设置有与缺口1031卡合的包边凸起201。还包括设置在包边凸起201外侧上的包边片50,包边片50的底部设置在大底30与第一中底10之间,包边凸起201的外侧面上设置有若干个固定凸起202,包边片50上设置有与固定凸起202卡合的通孔501。

[0049] 具体的,在前脚掌区的外侧的包边以第二中底20结构形成,通过填补的方式形成完整的包边,同时第二中底20的柔软性,可以为脚的大拇指和其侧边提供较为柔软的舒适性。

[0050] 进一步地,包边片50可以为TPU材料制作,对该位置的结构进行补强,同时配合第一加强片2031的连接,形成有底面至侧面的包覆,进而提高了结构的强度;既满足柔软性,还能包覆在鞋邦上,提供连接和支撑的效果,具有良好的结构强度。

[0051] 如图4所示,本实施例中包边凸起201的外侧面上设置有若干个固定凸起202,包边片50上设置有与固定凸起202卡合的通孔501,固定凸起202可以为三角形凸起、矩形凸起或圆形凸起等等,也可以为自行设计的异性凸起。通过固定凸起202和通孔501的配合,对包边片50进行定位粘合,同时可以提供结构支撑,提高结构配合的稳固性,使得包边片50可以提供更稳定的支撑。

[0052] 如图3所示,本实施例中第二中底20的前脚掌区且靠近耐磨鞋底内侧面设置有闭环凹槽203,闭环凹槽203上设置有嵌合的第一加强片2031;大底30的底面且靠近于耐磨鞋底的内侧面设置有圆形的纹理区301。

[0053] 具体的,闭环凹槽203可以为圆形,继而在闭环凹槽203内粘合一个同大小的圆环片(可以为EVA发泡片),加强该部位的结构强度。并且,圆环靠近前脚掌的外侧区域,可以提供支撑,防止崴脚。而纹理区301也可以为一个圆形区域,为前脚掌的发力处提供较好的结构强度,具有良好的实用性。

[0054] 进一步的,第一中底10与大底30于拼接线位置处设置有观测第一加强片2031的第一窗口100。通过拼合的结构设置第一中底10,可以更加灵活的设计鞋底的结构,并使得不同区域可以采用不同材料制作,已形成区域不同的结构强度;也可以采用相同材料制作,以便在第一中底10上设计结构,以提升相应的结构性能,如此可以降低鞋底的整体的重量,提高实用性。

[0055] 如图3所示,本实施例第一中底10为包含足弓区和后脚掌区的半掌结构,第一中底10于耐磨鞋底内侧设置有延伸部109,延伸部109上设置有第一拼接槽1011,第一中底10的足弓区内侧区设置有与第一拼接槽1011连通的第二拼接槽1012,第一中底10的足弓区外侧区设置有与闭环凹槽203连通的第三拼接槽1013;第一拼接槽1011、第二拼接槽1012和第三拼接槽1013形成耐磨槽102。

[0056] 具体的,延伸部109由足弓延伸至鞋尖区,配合第三拼接槽1013的结构,可以提供较大的粘合区域,使得第一中底10和大底30粘合。同时,第一中底10和大底30的中部都为弧面的凹槽,如此在两侧粘合后,可以在中部形成第一窗口100,以便观测鞋底内部,具有良好的美观性,同时也提供耐磨鞋底的弯曲性能。第二拼接槽1012则与第一拼接槽1011一体连

接成型,提高对大底30的粘合面积,继而提高结构的拼接强度。

[0057] 如图1所示,本实施例第一中底10的后脚掌侧面上设置有马蹄形的第二加强片105,第一中底10的外侧面上设置有第三加强片106,第三加强片106设置在前脚掌区与后脚跟之间。侧面上嵌入式粘合第二加强片105(可以为EVA发泡片),可以提供鞋后跟区域的结构强度,使得后跟具有良好的支撑强度,可以使得鞋后跟不易滑脱。而位于第三加强片106(可以为EVA发泡片),可以为耐磨鞋底和鞋邦的连接提供连接点,同时还可提供装饰,提高鞋底的美观。

[0058] 如图2和图3所示,本实施例中第一中底10的足弓区上设置有至少一个连通至碳板的第二窗口107;第一中底10的后脚掌区上设置有连通至第二中底20的第三窗口108。第二窗口107的设置,可以观测到鞋底内的碳板,同理第三窗口108可以观测到鞋第二中底20,如此便于消费则知晓耐磨鞋底的制作的层级和材质。同时,第二窗口107位于足弓区,可以提供减震缓冲的效果,即对人体脚部传递的力量,形成对第二窗口107内的塌陷,进而形成缓冲。而第三窗口108可以避开对人体后脚跟传导力量的缓冲,避免直接的力传导,在第三窗口108形成塌陷缓冲的目的。

[0059] 实施例二

[0060] 如图5所示,本实施例提供一种鞋子,包括实施例一中所记载的耐磨鞋底1,通过耐磨鞋底1可以提供良好的耐磨性,并且鞋子具有良好的弹性,可以为使用者提供较好的弹性性能。而第二中底20的柔性,则可以提供优秀的柔软性,提高穿着的舒适性能。整体上的重量设计较轻,能够为使用者提供较好的运动性能,降低长久运动下,鞋子对人体的负担,具有良好的实用性。

[0061] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

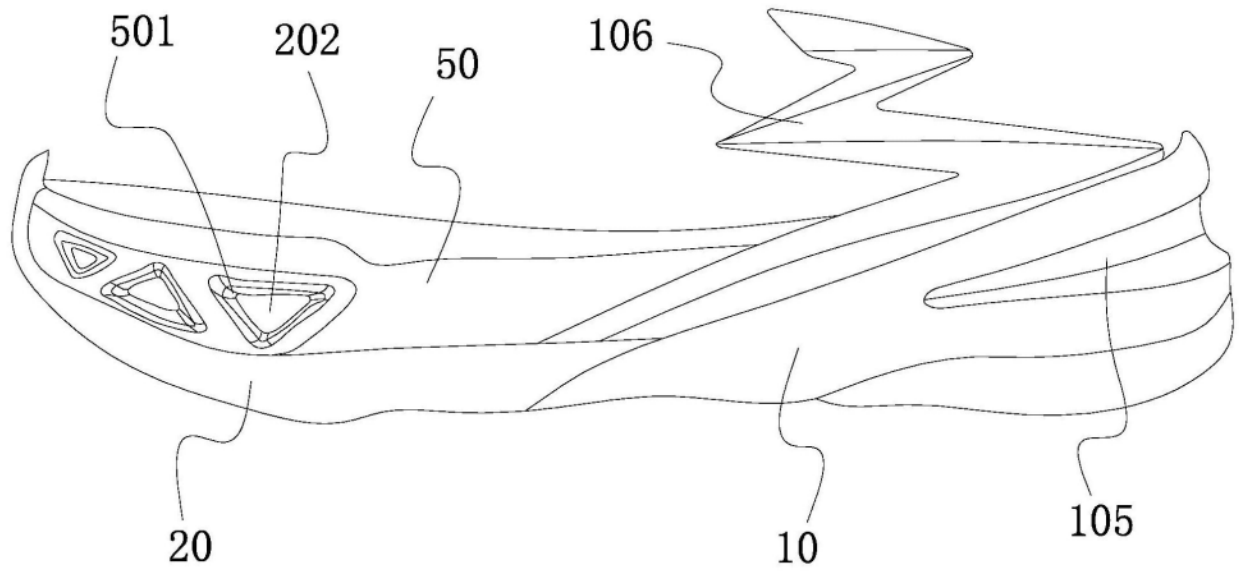


图1

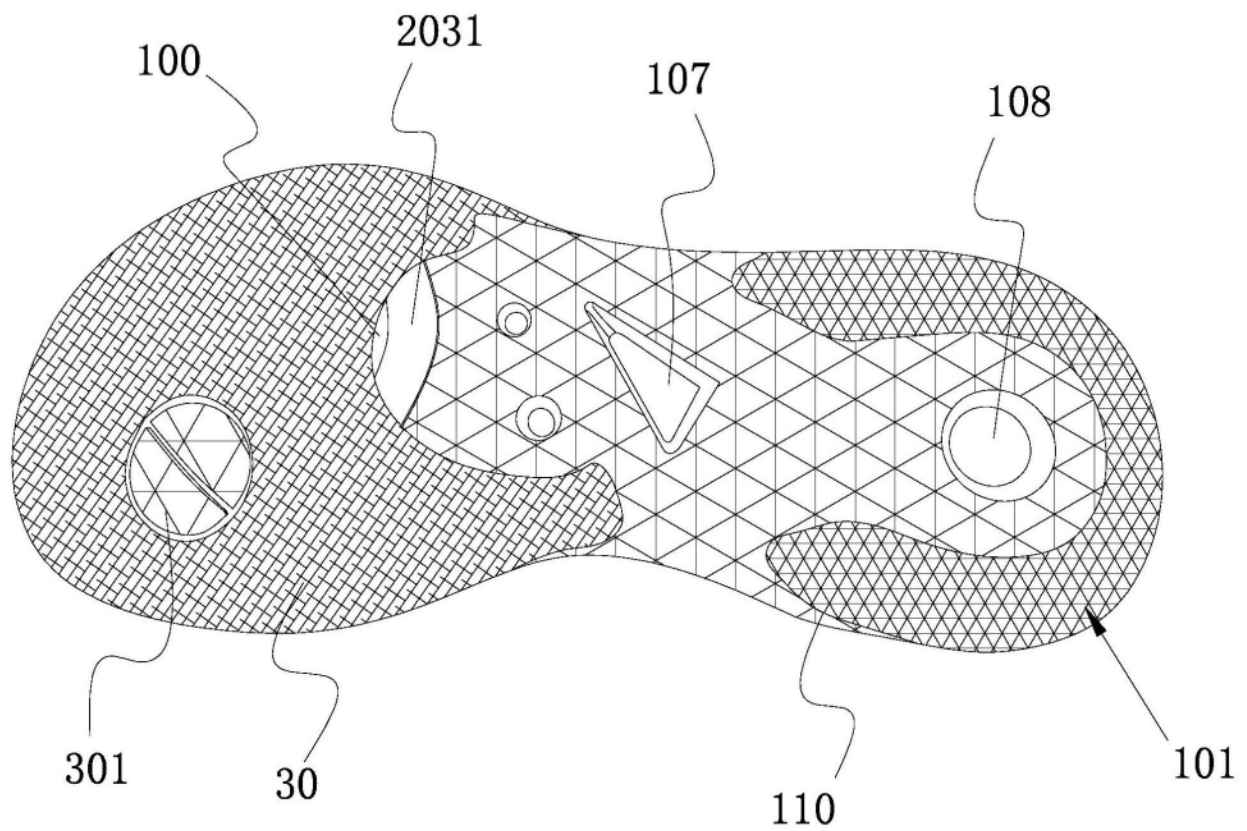


图2

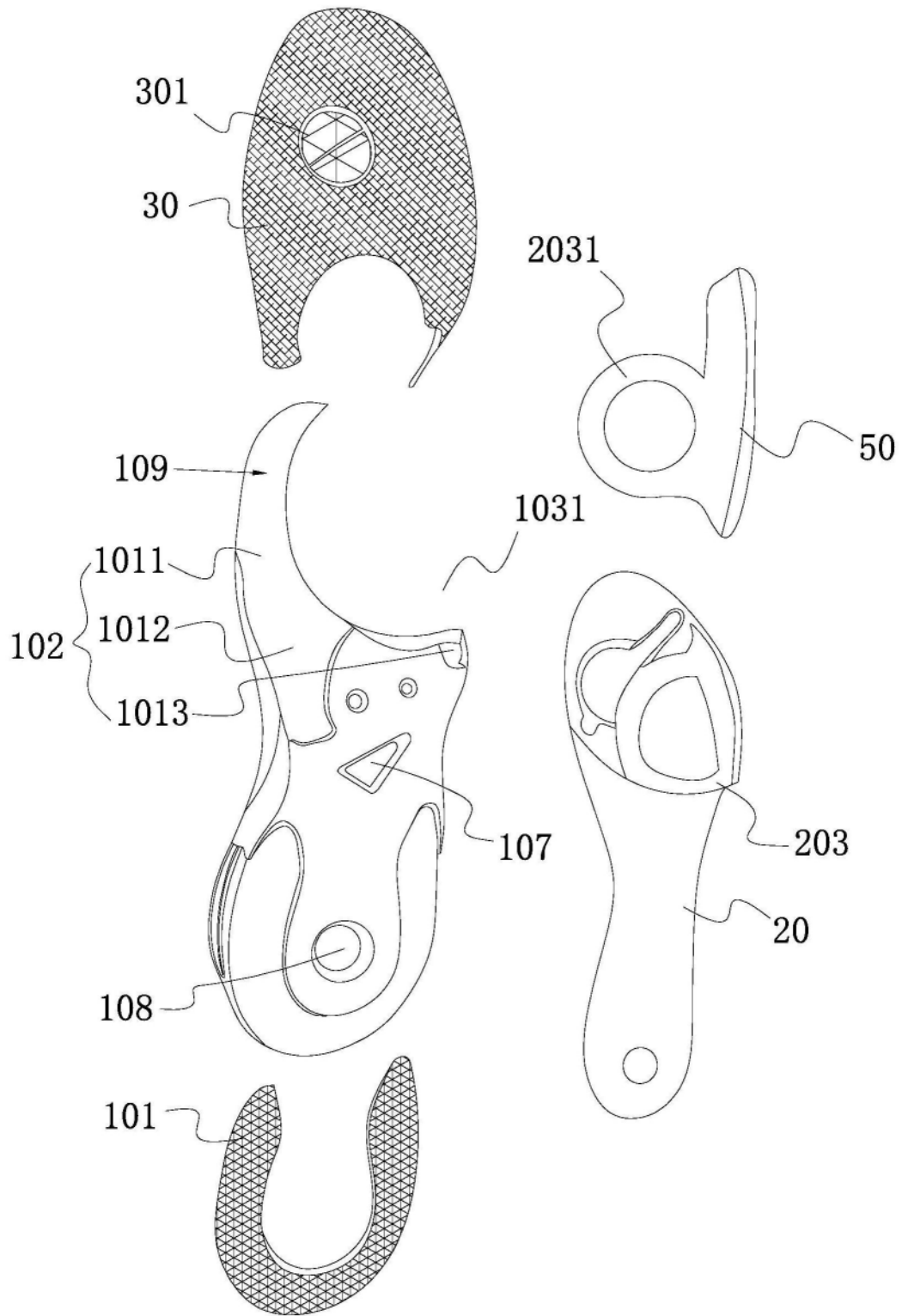


图3

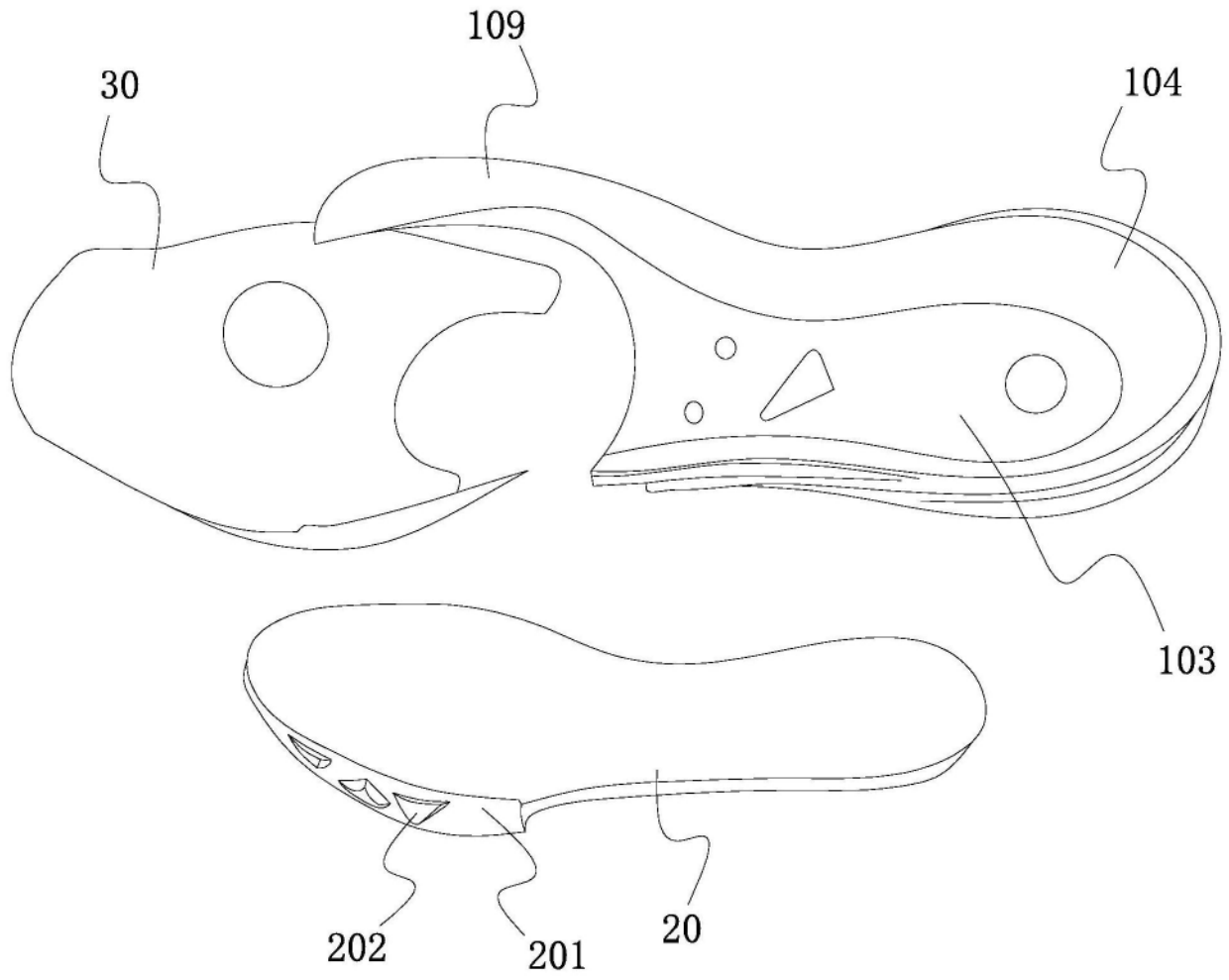


图4

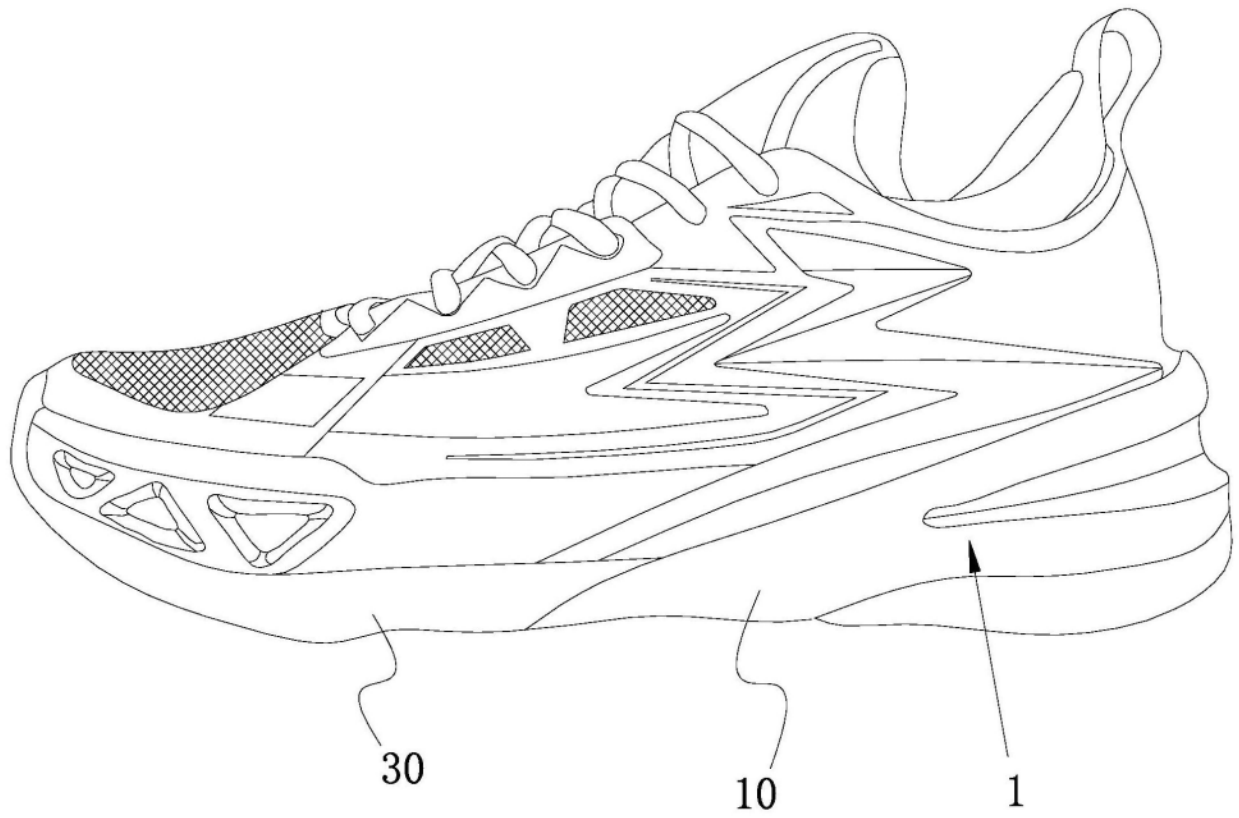


图5